科学研究**費**助成事業

研究成果報告書

科研費



研究成果の概要(和文):本研究は独自材料である「液体Si」を研究対象とし、電子線(EB)照射で進行する 「液体Si 固体Si」変換の実証とその原理解明を目的とした。目的達成のため、研究では液相(LP)-電子線誘起 堆積(EBID)装置を構築した。この装置を用いて液体Siに対しEB照射を行い、EB照射部において液体Si 非晶質 /結晶Si変換が誘起されるのを実証した。得られた固体Si膜中の不純物濃度はEDX装置の検出限界以下であり、高 純度な半導体Si膜であった。モンテカルロシミュレーションと密度反関数法を用いて相変換過程における反応活 性種の同定や影響に対する洞察を得た。非加熱・非真空で半導体Si薄膜の直接描画を実証した。

研究成果の学術的意義や社会的意義 申請者らが創出した「液体Si」とは、常温常圧で液体、脱水素化により固体Siとなる新物質である。液体Siを固 体Si(半導体Si膜)に変換するためには従来400 の熱を必要としていたが、本研究では非加熱・非真空でこの 変換を達成した。更に直接パターニング技術およびドープSi膜の形成にも成功した。この意義は従来のSi工学で は不可能とされてきた、非加熱・非真空でナノスケールの半導体Si膜の直接描画技術の確立にある。その学術的 意義は、100年続く固体Si(ウェハ)や気体Si(シランガス)に立脚した従来のSi工学を、「液体」という未踏領域 へ推し進めた点にある。

研究成果の概要(英文): This research focused on the unique material ``liquid Si'' and aimed to demonstrate the ``liquid-to-solid Si conversion'' induced by electron beam (EB) irradiation, as well as to clarify its mechanism. Using a liquid phase (LP)-electron beam induced deposition (EBID) equipment which was constructed by us, we irradiated EB on liquid Si and demonstrated that liquid-to-amorphous/crystalline Si conversion was induced in the EB irradiation area. The impurity concentration in the obtained solid Si film was below the detection limit of the EDX, and it was a highly pure semiconductor Si film. Montecarlo simulation and Density Functional Theory were used to gain insight into the identification and influence of reactive species in the phase transition. We succeeded direct writing of semiconductor Si thin films without heating/vacuum.

研究分野: 半導体工学

キーワード:液体プロセス シリコン半導体 液体Si

科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。 様 式 C-19、F-19-1、Z-19(共通)

1.研究開始当初の背景

100年に亘る Si 半導体の発展は、固体 Si(ウェハ)と気体 Si(シランガス)に基づく Si 工学発展の 歴史であった。一方で申請者らは近年「液体 Si」と呼ぶ新物質を創出した。これは常温常圧で液 体、脱水素化により固体 Si となる物質である。この材料の登場は 100 年続いた Si 半導体の歴 史に初めて「液体」からのアプローチを導入した。微細化に代表される Si 工学の発展が Si に係 る多様な新領域/新学術を創出してきたように、液体特有の機能・現象を発現させ、その潜在力を 引き出す「液体 Si 工学」の創出が、Si に更なる学術展開をもたらすと期待される。

2.研究の目的

固体 Si(ウェ八)や気体 Si(シランガス)に立脚した従来の Si 工学の延長には無い、新しい科学技 術「液体 Si 工学」の端緒を切り拓くことを目指す。本研究の目的は、液体 Si 工学の学術基盤と なる「液体 Si 固体 Si」変換機構の解明である。特に非加熱・非真空で進行する電子線誘起型の 機構を解明し、その理解の下、従来の Si 工学で困難とされた「非加熱・非真空の Si 製膜、Si 直 接描画」技術の創製に取り組む。

3.研究の方法

液体 Si として、シクロペンタシラン(Si5H10, 図1(a))を合成して用いた。この CPS に EB 照 射をし、液体から固体への Si 変換(固体 Si の析出)を分析した。CPS は液体容量 10 μ L の自作 密閉セル(図1(b))に封入された。EB 照射時の蒸発を防ぐためセル内の CPS は厚さ 100nm の SiN からなるグリッドを介して環境から分離された(図1(b,c))。EB 照射は、EB リソグラフィ装置 を用い、印加電圧 30 kV、ビーム径(1ピクセルの大きさ)50 nm で、SiN 窓越しに行った。照射 線量は、[パルス時間(秒/ショット),T] × [ビーム電流(A),I] × [ショット数,N]で計算し た。CPS/SiN 界面に EB を集光し、SiN 窓上に固体 Si を堆積させた。その後、グリッドをセルか ら取り出し、シクロヘキサンで洗浄し、乾燥させた。CPS と接触していた SiN 窓の部分に堆積し た Si ドットを分析した。

得られた Si ドットの寸法を走査型電子顕微鏡で測定した。Si フォノンバンドは、ラマン分光法によって得られた。集束イオンビーム (FIB) で試料をスライスし、透過型電子顕微鏡で断面 観察した。



図 1. 液相-電子ビーム誘起堆積法(LP-EBID)プロセスの模式図。(a)液体 Si(シクロペンタシ ラン;Si5H10)の写真と構造。(b)密閉セルと、(c)EB 照射部の拡大図。液体 Si を内部に封入し、 図中では上部から電子ビームを試料に対して垂直に照射する。赤い点線は EB の軌道を示す。EB は SiN 窓を通過し、液体 Si 試料に当たる。図は文献[1]掲載のものを微修正して掲載。

4.研究成果

図 2 (a) は Si 堆積物の SEM 像であり、EB を 500 nm 間隔でシングル画素ドット 4×4 配列して 照射した。EB 照射は、印加電圧 30kV、パルス時間 500 µ s、ビーム電流 200pA、ビーム径 50nm で 行った。各アレイの照射線量(0.8-20 pC)でショット数(8-200 ショット)を変えて照射した。 図 2(b)はドットサイズの線量依存性を示している。線量 1.6、2.4、8、10、20 pC で得られたド ットの平均直径はそれぞれ 110.4±18.4、115.4±4.5、205.3±4.1、229.9±4.7、350.0±34.5 μm であった。8pC と 10pC の線量で得られたドットの 3 値は平均直径の ± 7%以内であったが、 それ以外の線量で得られたドットの3 値は平均直径の11-50%と大きかった。このように、適切 な照射条件(ここでは 8pC と 10pC)を用いることで、ドットサイズのばらつきが少なくなる。 すべてのドットは入射 EB と同軸に成長し、線量が高くなると柱状になった。図では、1 ドット あたり 0.8-1.6pC の閾値線量が確認できる。線量が 1.6 pC から 20 pC まで増加すると、平均直 径はそれぞれ 110 nm から 350 nm まで増加した。20pC では、いくつかのドットの頂部が隣接す るドットに接続し始めた。図2(c)は、Si ドットの断面 TEM 像である(ドーズ=8 pC)。ドット は、SEM 観察用にスパッタされた白金(数ナノメートル)に加え、スライス加工用に樹脂とタン グステンで覆われていた。ドットの幅と高さはそれぞれ約 200nm と 700nm で、アスペクト比(高 さ/幅)は3以上であった。適切な照射条件により、軸が揃った明確な Si 構造が得られた。 方、低線量(1.6 pC と 2.4 pC)のドットは、サイズと方位が一定でない歪んだ構造になった。こ

れらの歪みから、析出には離散的な解離現象が関与していることが示唆され、それらは析出の初 期(核形成)段階で確認された。

ー次電子(PE)から Si 堆積物へのフォノンへのエネルギー移動により、EB 誘起加熱が起こる可 能性がある。試料の温度が液体 Si の沸点(194)を超えると、液体 Si は気化し始める。これ は、液体に局所的な気泡や意図しない流れを誘発し、堆積プロセスを妨害するため望ましくない。 したがって、EB 照射中の温度上昇を見積もる必要がある。金属基板上へのマイクロスケール EB (ビーム径 1 µm)の連続照射によって誘発される局所的な表面温度が報告されている[2]。われ われは 10-25 kV の電圧で報告されたデータを外挿することにより、印加電圧 30 kV における EB 誘起加熱の温度を推定したところ、15 C cm⁻²以下の線量では温度上昇は5 を超えないことが 示唆された。我々の実験で使用した線量は 0.04-1 C cm⁻²である。照射条件と物質が同じでない ため正確な判断は難しいが、我々が使用した線量は 5 上昇の推定線量より 1~2桁小さいため、 温度上昇は無視できると思われる。



図 2 (a) 液体 Si の LP-EBID。0.8-20pC(照射時間=500 µ s、ビーム電流=200pA、ショット数= 8-200)の異なる線量で得られた Si アレイ(4×4 ドット)の電子顕微鏡写真。すべてのスケー ルバーは 750 nm に対応する。(b) 線量とドット径(標準偏差付き、n=13-16)の関係。(c)ドッ トの断面 TEM 像(線量=8pC)。スケールバーは 200 nm に対応する。図は文献[1]掲載のものを微 修正して掲載。

図2は、析出の核形成段階またはその直後に成長を止めることによって、高分解能の構造が得ら れる可能性を示している。一方で十分な線量を照射すると、照射面積よりもかなり大きな構造が 得られる。ここでは、堆積物の成長が飽和するまで定位置で連続 EB 照射(200 pA、10 分間)を 行い、高さ5.5 µmのドットを作製した(図3(a)の走査電子顕微鏡写真)。このドットのフォ ノンバンドをラマン分光法で測定したところ、480 cmと160 cm⁻¹それぞれに横方向の光学バン ドと音響バンドに関連するピークを持つスペクトルが得られた(図3(b))。このスペクトルは 典型的なアモルファスSi(a-Si)[3]のスペクトルと一致し、EB 照射によってSi-H/Si-Si 結合の 切断とSi-Si 結合の再結合が起こり、a-Si ネットワークが形成されたことを示している。一般 に液体Si から得られた a-Si は、レーザーや加熱などの追加エネルギーによって結晶Si に変換 される。したがって、LP-EBID プロセスにおけるSi の結晶化度に対するより強い線量の影響を 評価することが今後必要である。

ヒドロシランの電子線照射によってさまざまな種類の活性種(ラジカルやイオン)が誘起される 可能性がある。Siの負イオンに関する報告もいくつかあるが[4]、水素化ケイ素は基本的にイオ ンよりもラジカルを生成しやすい。ガス状シラン(シリル、シリレン、シレン、またはシリン) 中のラジカルの寿命は圧力に依存し、0.16-70 µs である[5-7]。液相ヒドロシランのラジカルの 寿命に関する報告は少ないが、密な状態であるため、気相シランのラジカルの寿命よりも短い。 したがって、ラジカルの寿命は、照射された EB の時間(500 µs)に比べて十分に短いと考えら れる。反応性が高い(寿命が短い)ため、生成したラジカルは照射領域またはその周辺にのみ局在 し、照射 EB の時間内に急速に反応する。ヒドロシランに関連するほとんどのラジカル反応には Si-Si ネットワークを形成する能力があるため[8]、反応生成物は最終的に安定な a-Si に変換さ れる。活性種の種類と寿命はまだ明らかではないが、過渡吸収分光法などの特定の方法によって 明らかにできる可能性があり、今後の論文で報告したい。



図 3. 連続 EB 照射により得られた析出物。(a)走査電子顕微鏡写真、(b)ラマンスペクトル。図 は文献[1]掲載のものを微修正して掲載。

TEM とエネルギー分散型 X 線分光法 (EDX)の結果から、液体 Si の LP-EBID では、従来の EBID で得られた析出物よりもかなり高純度の析出物が得られる。図 4(a)は、図 3 のドットを FIB でスライスした断面 TEM 像と、ドットの中心で得られた回折パターンである。図4(a)の四角状 の領域 A および B は、組成分析中にさらなる調査を行った領域を示している。 析出物の内部はコ ントラストのない単調な色を示し、EB 回折点がないことを示している。これは、図3(b)のラ マンスペクトルによって裏付けられているように、非晶質の性質を持つ均一で緻密な析出物が 得られたことを示している。図 4(b)は、領域 A の 2 次元 EDX マッピングを示し、C、O、N、Si の 組成がプロットされている。中心から離れた領域では自然酸化による汚染が見られたが、中心部 ではほとんど汚染がなく、ドットの主成分は Si であった。図 4(c)は、点分析で得られたエリア BのEDXスペクトルとメインSiピークを中心とした狭いエリアのEDXスペクトルである。1.74keV に Si-K のメインピークがあり、ドットが純 Si であることがわかる。C(0.28keV)と O(0.53keV) のK ピークはバックグラウンドと同レベルであった。測定点はエリア B 内に限られていたが、 化学組成のばらつきは少なく、標準偏差は全元素で 0.2~0.3(n=6)であった。最悪の場合でも、 ドットの化学組成の 90 原子 (at) %以上が Si であり、不純物 (C、0、N) 濃度は 10at %未満で あった。これらの汚染は、スライス後の試料の大気暴露によって生じたと考えられる。Mo の小 さなピークは、使用した FIB-TEM グリッドメッシュによる汚染と関連しており、化学組成から除 外した。Liq-SiのLP-EBIDは、析出中にCとOを取り込む余地がないため、その含有量は低く、 高純度な Si 堆積を可能にした。



図 4. (a) 図 2 のドットの断面 TEM 像と回折パターン。試料はC層とW層でコーティングし て測定した。画像は均質なアモルファス構造を示している。図中の正方形 A と B は EDX で分析 した領域。(b)領域 A の 2 次元 EDX マッピング(Si、O、C、N)。(c)領域 B の 1 点 EDX スペクト ル。図は文献[1]掲載のものを微修正して掲載。

本研究は液体 Si に EB を照射し、加熱することなく液体から固体に Si を変換させた最初の研究 である。液体 Si は Si と H のみからなる理想的な Si 源であるため、LP-EBID は汚染の少ない半 導体 Si ドットを生成する。EBID はこれまで、最大 90at%の炭素不純物に悩まされてきたが[9]、 液体 Si の LP-EBID は汚染を避けることができ、それによって EBID を半導体 Si に利用する新た な道を開くことができる。液体 Si の LP-EBID では、ビーム径 50 nm、線量 2.4 pC で直径 120 nm の Si ドットを形成した。この分解能の大きさは、最先端の Si 加工で使用されているレジストベ ースのフォトリソグラフィの分解能限界よりも一桁大きかった。しかしフォトリソグラフィと は異なり、LP-EBID はエッチングやレジスト技術を必要としないシングルステップの直接描画技 術である。より高い印加電圧(より小さなビーム径)を持つ EBID システムの加工分解能は、現 在では 1 nm 以下となり、数ナノメートル規模の成膜が実現されている。したがって、液体 Si を用いた LP-EBID は、より高い印加電圧でより微細な加工分解能を達成できる可能性がある。今 回の成果は、ナノ・マイクロ加工、a-Si デバイス、Si の 3D プリント、デバイスのリペアなど に新たな加工技術を提供するものである。

[1] T. Masuda and M. Mori 2021 Direct writing of silicon nanostructures using liquidphase electron beam induced deposition of hydrosilanes *Nanotech.* **32** 195301

[2] Wang Z, Gui L, Han D, Xu Z, Han L and Xu S 2019 Measurement and Evaluation of Local Surface Temperature Induced by Irradiation of Nanoscaled or Microscaled Electron Beams *Nanoscale Res. Lett.* **14** 31

[3] Ishidate T, Inoue K, Tsuji K and Minomura S 1982 Raman Scattering in Hydrogenated Amorphous Silicon under High Pressure *Solid State Comm.* **42** 197–200

[4] Howling A A, Sansonnens L, Dorier J L and Hollenstein C 1993 Negative Hydrogenated Silicon Ion Clusters as Particle Precursors in RF Silane Plasma Deposition Experiments *J. Phys. D: Appl. Phys.* **26** 1003–6

[5] Tonokura K, Murasaki T and Koshi M 2002 Formation Mechanism of Hydrogenated
Silicon Clusters during Thermal Decomposition of Disilane *J. Phys. Chem. B* 106 555–63

[6] Tada N, Tonokura K, Matsumoto K, Koshi M, Miyoshi A and Matsui H 1999 Photolysis of Disilane at 193 nm *J. Phys. Chem. A* **103** 322–9

[7] Kono A, Hirose S and Goto T 1999 CW Laser-Induced Fluorescence Study of SiH2+ SiH4 Reaction *Jap. J. Appl. Phys.* **38** 4389–92

[8] Matsumoto K, Koshi M, Okawa K and Matsui H 1996 Mechanism and Product Branching Ratios of the SiH3 + SiH3 Reaction *J. Phys. Chem.* **100** 8796–801

[9] van Dorp W F and Hagen C W 2008 A critical literature review of focused electron beam induced deposition *J. Appl. Phys.* **104** 081301

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕 計2件(うち査読付論文 2件/うち国際共著 0件/うちオープンアクセス 0件)

- 1. 著者名	4.巻
Masuda Takashi, Mori Masahiro	32
2.論文標題	5 . 発行年
Direct writing of silicon nanostructures using liquid-phase electron beam induced deposition of	2021年
hydrosilanes	
3.雑誌名	6.最初と最後の頁
Nanotechnology	195301 ~ 195301
掲載論文のDOI(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.1088/1361-6528/abe0e9	有
「オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-
	•

	4. 奁
Mori Masahiro, Akabori Masashi, Tomitori Masahiko, Masuda Takashi	60
2.論文標題	5 . 発行年
Non-thermal liquid-to-solid Si conversion induced by electron beam irradiation	2021年
3. 雑誌名	6.最初と最後の頁
Japanese Journal of Applied Physics	SBBM03 ~ SBBM03
掲載論文のD01(デジタルオブジェクト識別子)	査読の有無
10.35848/1347-4065/abd9ce	有
オープンアクセス	国際共著
オープンアクセスではない、又はオープンアクセスが困難	-

〔学会発表〕 計3件(うち招待講演 1件/うち国際学会 1件)

1.発表者名
 增田貴史,森雅弘,中山茉初,齊藤公彦,片山博貴,寺川朗

2 . 発表標題

液体シリコンによるSiパターニングの研究

3 . 学会等名

薄膜材料デバイス研究会 第17回研究集会(招待講演)

4.発表年 2020年

1.発表者名

Masahiro Mori, Masashi Akabori, and Takashi Masuda

2.発表標題

Direct Writing of Si Nanostructures at Room Temperature by Electron Beam

3 . 学会等名

2020 International Conference on Solid State Device and Materials (SSDM 2020)(国際学会)

4.発表年 2020年

1.発表者名 森雅弘,赤堀誠志,富取正彦,増田貴史

2.発表標題

電子線照射による「液体Si 固体Si」の非加熱変換

3.学会等名第81回応用物理学会秋季学術講演会

4 . 発表年

2020年

〔図書〕 計0件

〔出願〕 計1件

産業財産権の名称 微小構造体及びその製造方法	発明者 増田貴史,森雅弘	権利者 国立大学法人北 陸先端科学技術 大学院大学
産業財産権の種類、番号	出願年	国内・外国の別
特許、特願2021-004101	2021年	国内

〔取得〕 計0件

〔その他〕

<u>6</u>.研究組織

1	氏名 (ローマ字氏名) (研究者番号)	所属研究機関・部局・職 (機関番号)	備考
---	------------------------------	-----------------------	----

7.科研費を使用して開催した国際研究集会

〔国際研究集会〕 計0件

8.本研究に関連して実施した国際共同研究の実施状況

共同研究相手国	相手方研究機関